



無料

金型業界で今注目されている 樹脂流動解析機能を体験してみませんか？

2015年2月19日に開催された日本金型工業会様主催「第3回金型関連技術発表講演会」にて樹脂流動解析ソフト「Autodesk Simulation Moldflow 2015」を使った金型業界向けの最新テクノロジーをご紹介いたしました。

今回イベントにご来場いただいたお客様をはじめ、現在導入をご検討いただいている企業様に、実際の操作性を体験していただけるハンズオンセミナーを企画いたしました。ご多忙とは存じますが、是非ご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。

■ 主催：株式会社CAEソリューションズ

協賛：オートデスク株式会社

■ 開催概要

2015年3月18日(水) 13:30~17:00

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー 3F

オートデスク株式会社大阪支社

■ 参加費：無料 ハンズオン6名様(先着順)



JR線、地下鉄御堂筋線
新大阪駅徒歩5分

アジェンダ

13:00 - 13:30	受付開始
13:30 - 13:40	ご挨拶 オートデスク株式会社 シミュレーション営業部 高橋 浩之様
13:40 - 14:10	Autodesk Simulation Moldflow 最新情報 金型業界で今トレンドの機能をご紹介 株式会社 CAEソリューションズ PLM事業部 前田 伸二
14:10 - 14:20	休憩10分
14:20 - 15:00	Autodesk Simulation Moldflow Adviserによる操作体験 ・金型冷却解析、反りの要因分析と評価
15:00 - 15:10	休憩10分
15:10 - 16:50	Autodesk Simulation Moldflow Insightによる操作体験 ・最近のトレンド 非定常金型冷却解析、コンフォーマル冷却解析など ・長繊維評価、Hear&Cool、解析体験
16:50 - 17:00	質疑応答

お申込み、および資料請求は以下のWebサイトを御覧下さい

https://sv111.xserver.jp/~caesc/cae-sc.com/mailform/basic/events_application.html

皆様のご参加をお待ちしております (ご同業社の方の参加はお断りさせていただきます)

記載されている企業名、商品名はそれぞれの商標または登録商標です

